

无锡芯朋微电子股份有限公司
关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司
提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

●为了满足日常经营和业务发展的需要，无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计向银行等金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过 2 亿元的担保额度。

●被担保人：全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有限公司。

●本次担保不存在反担保。

●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、申请综合授信额度并提供担保情况概述

为满足经营和发展需求，公司及子公司 2024 年度预计向银行等金融机构申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。

为提高公司决策效率，公司拟为全资子公司苏州博创集成电路设计有限公司、无锡安趋电子有限公司就上述综合授信额度内的融资提供不超过人民币 2 亿元的担保额度。担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限根据届时实际签

署的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

被担保方	提供担保额度（亿元）
苏州博创集成电路设计有限公司	1
无锡安趋电子有限公司	1
合计	2

上述担保额度可以在公司子公司和子公司之间进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司及子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为自 2023 年度股东大会通过之日起，至 2024 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

1. 苏州博创集成电路设计有限公司

苏州博创成立于 2008 年 3 月 14 日，注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街 388 号 22 幢 11 层 01&02&03&12 单元，注册资金 6000 万元，法定代表人易扬波，经营范围：研发、销售：半导体集成电路及半导体分立器件、电子产品、计算机软硬件；销售：仪器仪表、普通机械、电器机械、五金交电；提供相关技术服务；从事上述商品和相关技术的进出口业务。

股权结构：苏州博创为公司的全资子公司。

苏州博创最近一年主要财务数据如下：

单位：元

序号	主要财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年
1	资产总额	391,677,032.42
2	负债总额	70,171,707.23
3	资产净额	321,505,325.19
4	营业收入	110,789,536.54
5	净利润	6,309,650.30
6	资产负债率	17.92%

注：以上数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2. 无锡安趋电子有限公司

无锡安趋成立于 2017 年 8 月 8 日，注册地址为无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 10 楼，注册资金 500 万元，法定代表人张立新，经营范围：集成电路、半导体分立器件的研发、生产、销售；电子产品、计算机软硬件的开发、销售；仪器仪表、普通机械及设备、电器机械、五金产品的销售；技术服务；自营代理各类商品和技术的进出口业务。

股权结构：无锡安趋为公司的全资子公司。

无锡安趋最近一年主要财务数据如下：

单位：元

序号	主要财务数据	2023 年 12 月 31 日/2023 年
1	资产总额	79,521,946.35
2	负债总额	19,756,796.97
3	资产净额	59,765,149.38
4	营业收入	96,174,983.33
5	净利润	9,553,437.50
6	资产负债率	24.84%

注：以上数据经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计

三、担保合同的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

被担保人为公司全资子公司，融资是为满足其生产经营流动资金需要，上述担保事项是公司对于子公司拟向银行等金融机构申请的综合授信额度提供的预计担保。本次公司对子公司担保符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司的持续发展。

五、审议情况及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信额度及

为子公司提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司为子公司提供担保属于正常商业行为，且被担保公司经营稳定，资信情况良好，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。

（三）独立董事意见

独立董事认为：本次公司为子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保对象为公司全资子公司，能够有效控制和防范担保风险。该议案的决策和审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

保荐机构认为：本次公司为全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保事项经过了公司第五届董事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项仍需提交股东大会审议。该事项是为满足经营发展和扩大业务规模的需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不存在损害公司和投资者利益的情形。综上，保荐人对公司本次为全资子公司向银行等金融机构申请的综合授信额度并提供担保事项无异议。

六、累计对外担保总额及逾期担保的总额

截至公告日，公司及子公司对外担保总额为14,960万元，为公司对子公司的担保，分别占公司最近一期经审计总资产和净资产的5.38%和6.01%。除此之外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

七、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于无锡芯朋微电子股份有限公司为全资子公司提供担保的核查意见

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司

董事会

2024年4月13日